

Abstract

Electronic component with multilayered rewiring plate and method for producing the same

The invention relates to an electronic component (1) having a multilayered rewiring plate (2), which carries a circuit chip (3), in particular a magnetic memory chip (4), and connects contact areas (5) of the chip to external contacts (7) of the electronic component (1) via rewiring lines (6). The rewiring plate (2) has at least one patterned, magnetic shielding layer (8) made of an amorphous metal or an amorphous metal alloy. Furthermore, the invention encompasses a method for producing this electronic component (1).

[Figure 1]

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
8. Januar 2004 (08.01.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/004006 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 23/552, 23/498, G11C 11/15

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/002162

(22) Internationales Anmeldedatum:
30. Juni 2003 (30.06.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 29 542.5 1. Juli 2002 (01.07.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-
Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): THOMAS, Jochen
[DE/DE]; Ottilienstr. 46 A, 81827 München (DE). WEN-
NEMUTH, Ingo [DE/DE]; Josephsburgstr. 146 A, 81825
München (DE).

(74) Anwalt: SCHWEIGER, Martin; c/o Schweiger & Part-
ner, Karl-Theodor-Str. 69, 80803 München (DE).

(81) Bestimmungsstaat (national): US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

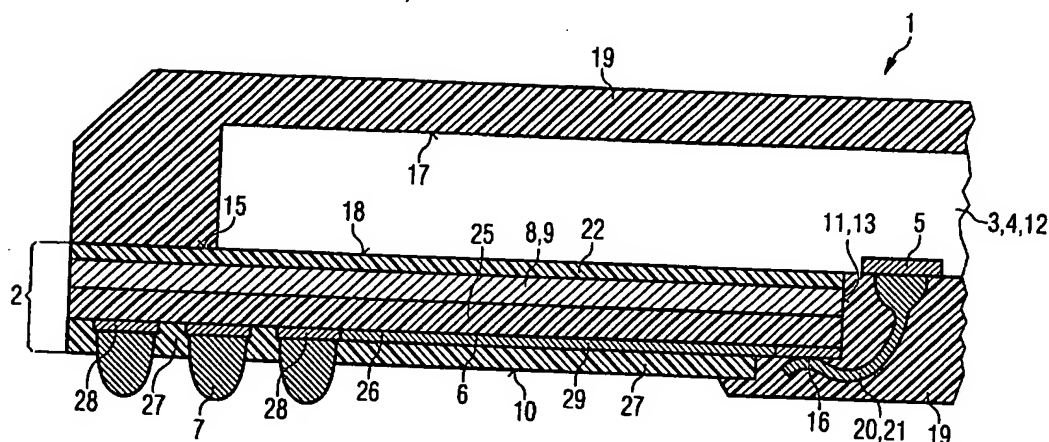
Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING A MULTILAYER WIRING FRAME AND METHOD FOR PRODUC-
ING THE SAME.

(54) Bezeichnung: ELEKTRONISCHES BAUTEIL MIT MEHRSCICHTIGER UMVERDRAHTUNGSPLATTE UND VER-
FAHREN ZUR HERSTELLUNG DESSELBEN



(57) Abstract: The invention relates to an electronic component (1) comprising a multilayer wiring frame (2) that carries a circuit chip (3), especially a magnetic memory chip (4) and that links the contact surfaces of the chip (5) with the external contacts (7) of the electronic component (1) via internal wires (6). The wiring frame (2) comprises at least one structured magnetic shielded layer (8) that consists of an amorphous metal or an amorphous metal alloy. The invention further relates to a method for producing said electronic component (1).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil (1) mit einer mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte (2), die einen Schaltchip (3), insbesondere einen magnetischen Speicherchip (4) trägt und Kontaktflächen des Chips (5) über Umverdrahtungsleitungen (6) mit Außenkontakten (7) des elektronischen Bauteils (1) verbindet. Die Umverdrahtungsplatte (2) umfasst mindestens eine strukturierte magnetisch abgeschirmte Schicht (8), die aus einem amorphen Metall oder einem amorphem Metalllegierung besteht. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung des Bauteils (1).

VO 2004/004006 A1